

S1R72005B00A300/F00A300

テクニカルマニュアル

本資料のご使用につきましては、次の点にご留意願います。

1. 本資料の内容については、予告無く変更することがあります。
2. 本資料の一部、または全部を弊社に無断で転載、または、複製など他の目的に使用することは堅くお断りいたします。
3. 本資料に掲載される応用回路、プログラム、使用方法等はあくまでも参考情報であり、これらに起因する第三者の権利（工業所有権を含む）侵害あるいは損害の発生に対し、弊社はいかなる保証を行うものではありません。また、本資料によって第三者または弊社の工業所有権の実施権の許諾を行うものではありません。
4. 特性値の数値の大小は、数直線上の大小関係で表しています。
5. 本資料に掲載されている製品のうち「外国為替および外国貿易法」に定める戦略物資に該当するものについては、輸出する場合、同法に基づく輸出許可が必要です。
6. 本資料に掲載されている製品は、一般民生用です。生命維持装置その他、きわめて高い信頼性が要求される用途を前提としていません。よって、弊社は本（当該）製品をこれらの用途に用いた場合のいかなる責任についても負いかねます。

総則

・適用範囲

本仕様書は、セイコーエプソン株式会社 半導体事業部製

USB OnTheGo コントローラ「S1R72005B00A300」および「S1R72005F00A300」に適用する。

目次

1. 概要	1
2. 特長	1
3. ブロック図	2
4. 端子配置図	3
4.1 CSPパッケージ	3
4.2 QFPパッケージ	4
5. 端子機能説明	5
5.1 CPU インタフェース	5
5.2 USBインタフェース	6
5.3 システム系	7
5.4 テスト信号	7
5.5 電源・GND・その他	8
6. 機能概要	9
6.1 Host Controller (HC)	9
6.2 Peripheral Controller (PC)	9
6.3 OTG Controller	9
6.4 HC/PC Common	9
6.5 USB Transceiver	9
6.6 Control Registers	9
6.7 FIFO Manager	10
6.8 FIFO SRAM	10
6.9 CPU I/F	10
6.10 DMA Handler	10
6.11 CLK Controller	10
6.12 Test Module	10
7. 電気的特性	11
7.1 絶対最大定格	11
7.2 推奨動作条件	11
7.3 DC特性	12
7.4 AC特性	15
7.4.1 クロックタイミング	15
7.4.1.1 パワーオン発振安定時間	15
7.4.1.2 CLKIN(27MHz)クロック入力タイミング	15
7.4.1.3 CLKIN(48MHz) クロック入力タイミング	16
7.4.1.4 CLKIN(12MHz) クロック入力タイミング	16
7.4.2 CPU I/F アクセス タイミング	17

7.4.2.1	リード タイミング (外部xWAITモード)	17
7.4.2.2	ライト タイミング (外部xWAITモード)	18
7.4.2.3	リード タイミング (外部 xREADYモード)	19
7.4.2.4	ライト タイミング (外部 xREADYモード)	20
7.4.2.5	リード タイミング (固定WAITモード)	21
7.4.2.6	ライト タイミング (固定 WAITモード)	22
7.4.3	DMAタイミング	23
7.4.3.1	xRD・xWR ストローブモード(DMAOUT)	23
7.4.3.2	xRD・xWR ストローブモード(DMAIN)	24
7.4.3.3	DACKストローブモード(DMAOUT)	25
7.4.3.4	DACK ストローブモード(DMAIN)	26
7.4.3.5	DMASTRB SDRAMモード(DMAOUT)	27
7.4.3.6	DMASTRB SDRAM モード(DMAIN)	28
7.4.3.7	DMASTRB 汎用モード (DMAOUT)	29
7.4.3.8	DMASTRB 汎用モード (DMAIN)	30
7.4.4	USB I/F タイミング	31
8.	外形寸法図	32
8.1	CSPパッケージ	32
8.2	QFPパッケージ	33
9.	接続例	34
9.1	OTG I/F端子接続例	34
9.2	クロック端子接続例	36
9.3	CPU I/F端子接続例	38
9.4	電源およびグランド端子接続例	39
9.5	テスト端子接続例	40

1. 概要

本 LSI は USB2.0 準拠の Full Speed (12Mbps) モードに対応した On-The-Go デバイスコントローラ LSI です。Host と Peripheral の両機能に加え On-The-Go の機能を 1 chip に集積し、Dual-role device としての動作を実現します。

USB 機器と PC との汎用的な接続性を従来どおりに提供すると共に、USB 機器同士による自由な接続性を新たに提供します。USB インタフェース電源(3.3V)と独立して CPU インタフェース用電源(2.8V～3.3V)を供給でき、さまざまな外部 CPU と接続可能です。

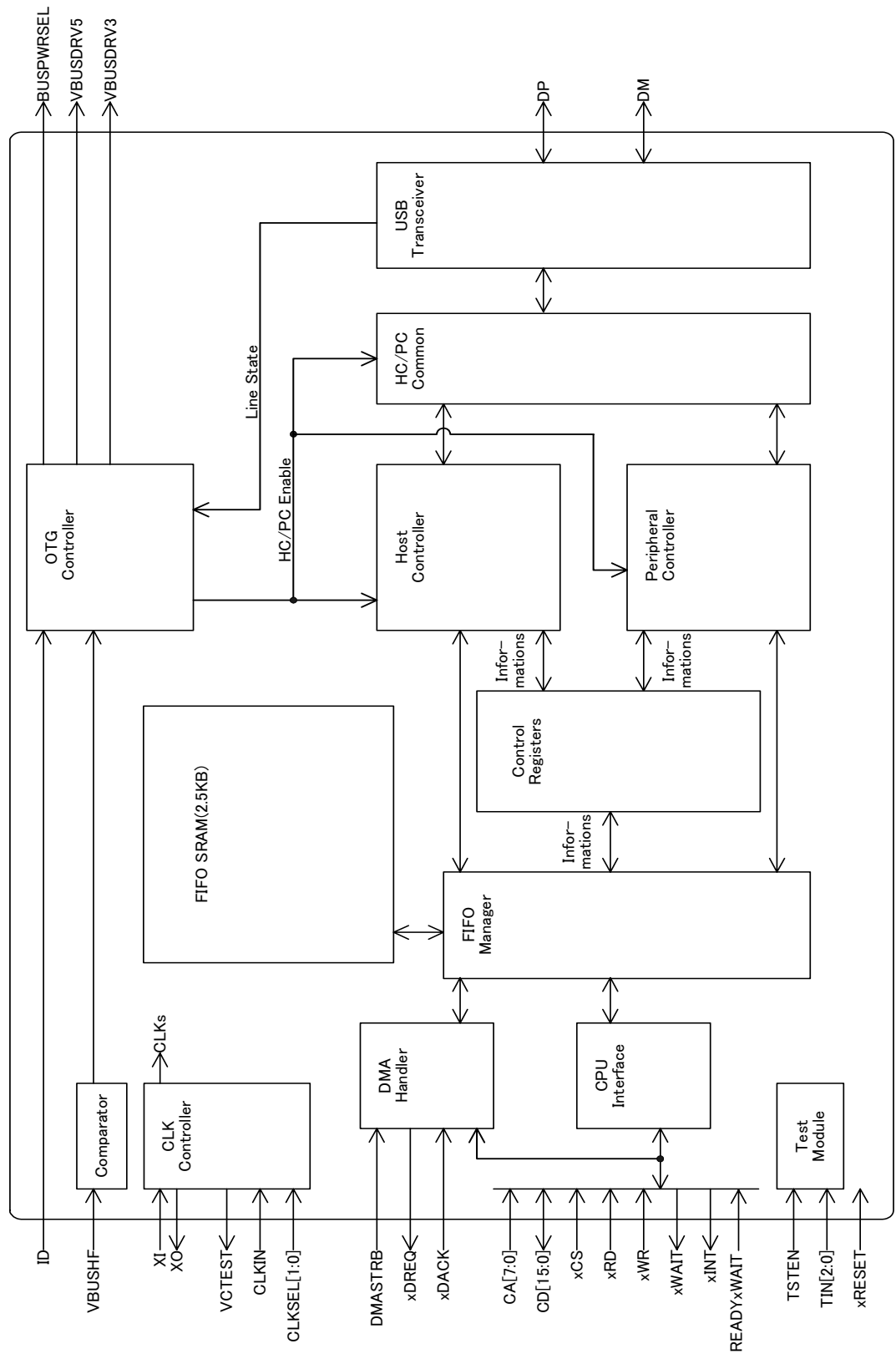
2. 特長

- Host 機能、Peripheral 機能、On-The-Go 機能をワンチップに搭載。
- I/O 2 電源対応 (USB 3.3V / CPUIF 2.8V～3.3V)
- On-The-Go (Supplement to the USB2.0) 1.0 版準拠。
- USB2.0 Full Speed (12Mbps) モードをサポート。
- On-The-Go ポート 1 個を装備。
- コントロール、バルク、インタラプト、およびアイソクロナス転送をサポート。
- USB 転送時の CPU 負荷低減と高スループットを実現するコントローラ・インタフェース。
- Peripheral 動作時、Endpoint 0 および 5 本の汎用 Endpoint をサポート。
- データ転送用 2.5kByteFIFO を内蔵。
- FIFO はリング・バッファ方式を採用。
- 16bit 幅の汎用 CPU I/F を搭載。
- 16bit 幅の汎用 DMA スレーブとして動作可能 (CPU I/F とバスを共用)。
- クロック入力 12MHz の発振子に対応 (発振回路内蔵)。
- 逡倍 PLL 回路を内蔵。
- 水晶発振器からの外部クロック入力 12MHz、27MHz、48MHz にも対応。
- 徹底したクロック制御による低消費電力の実現。
- 81pin CSP パッケージまたは 64pin QFP パッケージ

※耐放射線設計はされておりません。

3. ブロック図

3. ブロック図



4. 端子配置図

4.1 CSP パッケージ

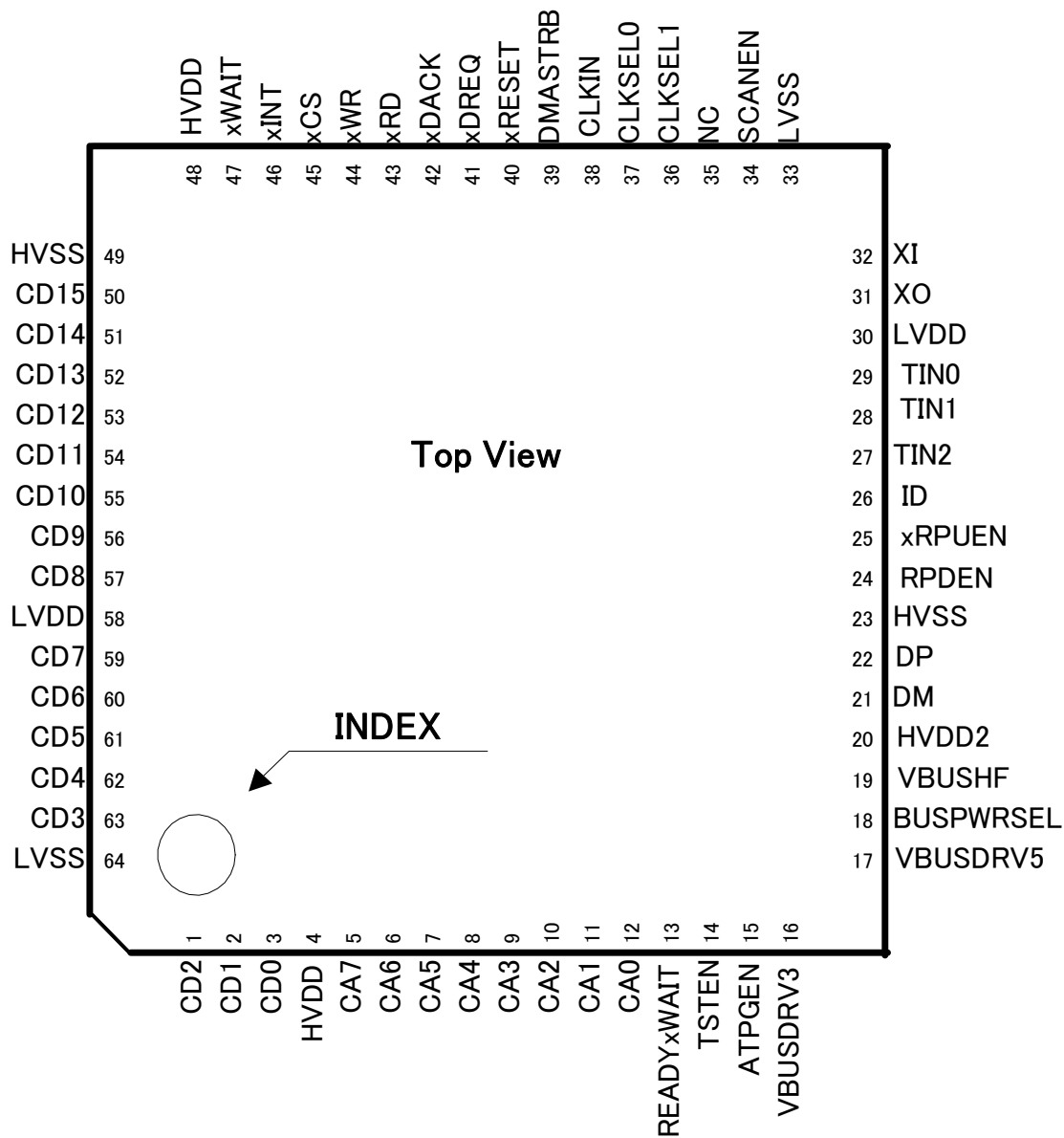
J		VBUS DRV5	VBUSHF	DM	RPDEN	ID	LVDD	XI	
H	VBUS DRV3	READYx WAIT	BUS PWRSEL	DP	HVSS	TIN2	XO	TIN0	LVSS
G	TSTEN	ATPGEN	HVDD2			TIN1	CLKSEL 1	SCANEN	
F	CA2	CA1	CA0		XRPUE			CLKIN	CLKSEL 0
E	CA3	CA4	CA5			COMPIN 22	DMA STRB	XRESET	XDREQ
D	CA7	CA6				COMPIN 10	XWR	XRD	XDACK
C	CD0	CD1	HVDD	CD6	CD10		CD13	XWAIT	XINT
B	CD2	CD5	CD3	CD7	CD9	CD11	CD15	XCS	HVDD
A		LVSS	CD4	LVDD	CD8	CD12	CD14	HVSS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bottom View

※READYxWAIT および HVDD, HVDD2 は、S1R72005B00A100 より変更が生じた端子です。

4. 端子配置図

4.2 QFP パッケージ



※READYxWAIT および HVDD、HVDD2 は、S1R72005B00A100 より変更が生じた端子です。

5. 端子機能説明

5.1 CPU インタフェース

記号	端子名称	端子番号		端子種類	機能説明
		CSP	QFP		
DMASTRB	DMA Strobe	E7	39	I(Gated CMOS)	バースト DMA 転送用のストロブ信号 未使用時は GND(HVSS)に接続
xDREQ	DMA Request	E9	41	O(3-state 3mA)	DMA 転送要求 初期状態は HiZ レジスタ設定によりローアクティブ/ ハイアクティブが選択可能
xDACK	DMA Acknowledge	D9	42	I(Gated CMOS)	DMA 転送許可
xRD	Read Strobe	D8	43	I(Gated CMOS)	CPU リードストロブ
xWR	Write Strobe	D7	44	I(Gated CMOS)	CPU ライトストロブ
xCS	Chip Select	B8	45	I(CMOS)	チップセレクト信号
xINT	Interrupt signal	C9	46	O(3-state 3mA)	CPU への割り込み信号 初期状態は HiZ レジスタ設定により HiZ/0、1/0 が選 択可能
xWAIT	Wait signal	C8	47	O(3-state 3mA)	CPU へのウェイト信号 初期状態は HiZ レジスタ設定により HiZ/0、1/0 が選 択可能
READYxWAIT	ReadySelect	H2	13	I(CMOS シュミット)	xWAIT 信号を READY モードで使用する 場合に"H"を入力する。初期設定端子で あり、動作中に変化させてはならない。
CD15 CD14 CD13 CD12 CD11 CD10 CD9 CD8 CD7 CD6 CD5 CD4 CD3 CD2 CD1 CD0	CPU Data	B7 A7 C7 A6 B6 C5 B5 A5 B4 C4 B2 A3 B3 B1 C2 C1	50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 1 2 3	I/O (Gated CMOS 3mA)	CPU データバス 初期状態は入力モード リード時には、レジスタデータが出力さ れ、ライト時には、CPUよりレジスタ データを設定する DMA データバスと共用
CA7 CA6 CA5 CA4 CA3 CA2 CA1 CA0	CPU Address	D1 D2 E3 E2 E1 F1 F2 F3	5 6 7 8 9 10 11 12	I(Gated CMOS)	CPU アドレスバス。 レジスタアドレスを指定する

5. 端子機能説明

5.2 USB インタフェース

記号	端子名称	端子番号		端子種類	機能説明
		CSP	QFP		
VBUSDRV3	VBUS Drive	H1	16	O (3mA)	VBUS3.3V ドライブのイネーブル 0 : ディセーブル、1 : イネーブル 初期状態はディセーブル 未使用時はオープン
VBUSDRV5	VBUS Drive	J2	17	O (3mA)	VBUS5V ドライブ(max 8mA)のイネーブル 0 : ディセーブル、1 : イネーブル 初期状態はディセーブル
BUSPWSEL	VBUS Drive	H3	18	O (3mA)	VBUS5V ドライブ(over 8mA)のイネーブル 0 : ディセーブル、1 : イネーブル 初期状態はディセーブル
COMPIN10	1.0V レベル 検出信号	D6	—	I(CMOS 120K Ω pull down 付)	VBUS/2 レベル検出結果(1.0V) 0 : VBUS/2 < 1.0V、1 : VBUS/2 \geq 1.0V 内蔵コンパレータ使用時は GND に接続
COMPIN22	2.2V レベル 検出信号	E6	—	I(CMOS 120K Ω pull down 付)	VBUS/2 レベル検出結果(2.2V) 0 : VBUS/2 < 2.2V、1 : VBUS/2 \geq 2.2V 内蔵コンパレータ使用時は GND に接続
DM	USB 負極信号	J4	21	I/O (special)	USB データライン D ⁻
DP	USB 正極信号	H4	22	I/O (special)	USB データライン D ⁺
RPDEN	Rpd Enable	J5	24	O (3mA)	D+プルダウンのイネーブル 0 : ディセーブル、1 : イネーブル 内蔵抵抗使用時はオープン
xRPUEN	Rpu Enable	F5	25	O (3mA)	D+プルアップのイネーブル 0 : イネーブル、1 : ディセーブル 内蔵抵抗使用時はオープン
ID	ID 信号	J6	26	I(CMOS シュミット 120K Ω pull up 付)	ID 信号 0 : A-Device、1 : B-Device
VBUSHF	VBUS/2	J3	19	I (special)	VBUS/2 レベル 外部コンパレータ使用時は GND に接続

5.3 システム系

記号	端子名称	端子番号		端子種類	機能説明
		CSP	QFP		
XO	発振子出力	H7	31	O (special)	内部発振回路用出力 未使用時はオープン
XI	発振子入力	J8	32	I (special)	内部発振回路用入力 未使用時は、プルダウン抵抗を介して GND(LVSS)に接続
CLKSEL1 CLKSEL0	クロック選択	G7 F9	36 37	I(CMOS シュミット)	発振子使用および外部クロック使用の 選択端子 CLKSEL[1:0] 00 : 12MHz 発振子使用 01 : 外部 27MHz クロック入力使用 10 : 外部 48MHz クロック入力使用 11 : 外部 12MHz クロック入力使用
CLKIN	外部クロック 入力	F8	38	I(TTL)	外部クロック入力。 未使用時は、GND(HVSS)に接続 外部クロック入力使用時は、リセット解 除までに安定したクロック供給を行っ ていること
XRESET	Chip reset	E8	40	I(CMOS シュミット 120K Ω pull up 付)	チップリセット

5.4 テスト信号

記号	端子名称	端子番号		端子種類	機能説明
		CSP	QFP		
TIN2 TIN1 TIN0	Test mode	H6 G6 H8	27 28 29	I (CMOS シュミット 120K Ω pull down 付)	モード設定入力端子 000 : Normal その他 : Internal test mode 通常使用時は GND(HVSS)に接続する
TSTEN	Test enable	G1	14	I (TEST I/O)	テストイネーブル端子 0 : Normal、1 : Test 通常使用時は GND(HVSS)に接続する
ATPGEN	Test ATPG	G2	15	I (CMOS シュミット 120K Ω pull down 付)	テスト端子 通常使用時は GND(HVSS)に接続する
SCANEN	Test SCAN	G8	34	I (CMOS シュミット 120K Ω pull down 付)	テスト端子 通常使用時は GND(HVSS)に接続する

5. 端子機能説明

5.5 電源・GND・その他

記号	端子名称	端子番号		端子種類	機能説明
		CSP	QFP		
HVDD	Power Supply for I/O Part	C3, B9	4, 48	P	I/O 用 2.8~3.3V 電源端子
HVDD2	Power Supply for USB Part	G3	20	P	USB インターフェース用 3.3V 電源端子
HVSS	Ground for I/O Part	H5, A8	23, 49	P	I/O 用接地端子
LVDD	Power Supply for Logic part	J7, A4	30, 58	P	内部用 2.5V 電源端子
LVSS	Ground for Logic part	H9, A2	33, 64	P	内部用接地端子
NC	None Connect	C6, D3, D4, D5, E4, E5, F4, F6, F7, G4, G5, G9, A1, A9, J1, J9	35	—	未使用端子 通常使用時はオープン

※READYxWAIT および HVDD、HVDD2 は、S1R72005B00A100 より変更が生じた端子です。

6. 機能概要

6.1 Host Controller (HC)

- 複数トランザクション間の調停、フレームにおける時間管理、転送のスケジューリング、および再送の管理を行います。
- トランザクション管理を行います。
- パケットを生成／分解します。
- サスペンド／レジューム／リセット状態生成の指示を行います。

6.2 Peripheral Controller (PC)

- エンドポイントのオペレーション情報をレジスタを介して管理します。
- トランザクション管理を行います。
- パケットを生成／分解します。
- リモートウェイクアップ信号生成の指示を行います。

6.3 OTG Controller

- USB データライン状態（コネクタ／ディスコネクタを含む）を監視します。
- VBUS レベルを監視します。
- ID を監視します。
- OTG 動作を実施するための VBUS 駆動／停止、プルアップ／プルダウン抵抗 (D+) 接続／切断、HC／PC のイネーブル／ディセーブルを制御します。

6.4 HC/PC Common

- USB データライン状態生成の指示を行います。
- USB Transceiver に対し、HC または PC との接続切替を行います。

6.5 USB Transceiver

- パラレル／シリアル変換処理を行います。
- ビットスタッフィング／アンスタッフィング処理を行います。
- NRZI エンコード／デコード 処理を行います。
- USB データ信号の送受信を行います。
- USB データライン状態を生成します。

6.6 Control Registers

- トランザクションおよびエンドポイントの制御に関するレジスタ群を保有します。

6. 機能概要

6.7 FIFO Manager

- CPU/DMA、USB による FIFO アクセス用アドレスを管理します。
- CPU/DMA、USB による FIFO アクセスのアービトレーションを管理します。

6.8 FIFO SRAM

- データ転送用 FIFO（計 2.5kByte）として使用します。

6.9 CPU I/F

- PIO 転送の制御を行います。
- CPU へのインタラプト信号を生成します。

6.10 DMA Handler

- DMA 転送（DMA スレーブ）の制御を行います。
-

6.11 CLK Controller

- 通倍 PLL（発振子使用時）により、または外部からの入力クロックにより、内部で使用する各種クロックを生成します。
- ブロック毎に使用するクロック動作の制御を行います。

6.12 Test Module

- 内部の動作確認テストを行います。

7. 電気的特性

7.1 絶対最大定格

(VSS=0V)

項目	記号	定格値	単位
電源電圧	HVDD*	-0.3~4.0	V
	HVDD2	-0.3~4.0	V
	LVDD*	-0.3~3.0	V
入力電圧	HVI1	-0.3~HVDD+0.5	V
	HVI2	-0.3~HVDD2+0.5	V
	LVI	-0.3~LVDD+0.5	V
出力電圧	HVO1	-0.3~HVDD+0.5	V
	HVo2	-0.3~HVDD2+0.5	V
	LVO	-0.3~LVDD+0.5	V
出力電流／端子	IOUT	±30	mA
保存温度	Tstg	-65~150	°C

*HVDD2、HVDD ≥ LVDD

7.2 推奨動作条件

項目	記号	MIN	TYP	MAX	単位
電源電圧	HVDD2	3.00	3.30	3.60	V
	HVDD	2.70	—	3.60	V
	LVDD	2.30	2.50	2.70	V
入力電圧	HVI1	VSS	—	HVDD	V
	HVI2	VSS	—	HVDD	V
	LVI	VSS	—	LVDD	V
周囲温度	Ta	-40	25	85	°C

7. 電気的特性

7.3 DC 特性

DC 特性(推奨動作条件による) (1)

項 目	記 号	条 件	Min.	Typ.	Max.	単位
消費電流						
電源電流	IDDH	HVDD = 3.6V	-	-	10	mA
	IDDH2	HVDD2 = 3.6V	-	-	10	mA
	IDDL	LVDD = 2.7V	-	-	40	mA
静止電流 (HVDD~VSS 間の静止電流)						
電源電流	IDDSH	VIN = HVDD or HVDD2 or VSS HVDD = 3.6V LVDD = 2.7V	-	-	30	μ A
静止電流 (HVDD2~VSS 間の静止電流)						
電源電流	IDDSH2	VIN = HVDD or HVDD2 or VSS HVDD2 = 3.6V LVDD = 2.7V	-	-	30	μ A
静止電流 (LVDD~VSS 間の静止電流)						
電源電流	IDDSL	VIN = HVDD or HVDD2 or VSS HVDD = 3.6V LVDD = 2.7V	-	-	60	μ A
入力リーク						
入力リーク電流	IL	VIN = HVDD or HVDD2 or VSS HVDD = 3.6V HVDD = 3.6V LVDD = 2.7V HVIH = HVDD LVIL = LVDD VIL = VSS	-5	-	5	μ A

DC 特性(推奨動作条件による) (2)

項 目	記 号	条 件	Min.	Typ.	Max.	単位
入力特性 (CMOS)	端子名 :	CA7..CA0, CD15..CD0, TSTEN, xCS, xDACK, xRD, xWR, DMASTRB, COMPIN10, COMPIN22				
"H"レベル入力電圧	VIH1H	HVDD = 3.6V	2.2	-	-	V
"L"レベル入力電圧	VIL1H	HVDD = 2.7V	-	-	0.8	V
シュミット入力特性 (CMOS)	端子名 :	xRESET, CLKSEL1, CLKSEL0, TIN2, TIN1, TIN0, SCANEN, ATPGEN				
"H"レベルトリガ電圧	VT1+	HVDD = 3.6V	1.4	-	2.7	V
"L"レベルトリガ電圧	VT1-	HVDD = 2.7V	0.6	-	1.8	V
ヒステリシス電圧	$\Delta V1$	HVDD = 2.7V	0.3	-	-	V
シュミット入力特性 (CMOS)	端子名 :	ID				
"H"レベルトリガ電圧	VT2+	HVDD2 = 3.6V	1.4	-	2.7	V
"L"レベルトリガ電圧	VT2-	HVDD2 = 3.0V	0.6	-	1.8	V
ヒステリシス電圧	$\Delta V2$	HVDD2 = 3.0V	0.3	-	-	V
入力特性 (LVTTTL)	端子名 :	CLKIN				
"H"レベル入力電圧	VIH2H	HVDD = 3.6V	2.0	-	-	V
"L"レベル入力電圧	VIL2H	HVDD = 2.7V	-	-	0.8	V
シュミット入力特性 (USB:FS)	端子名 :	DP, DM				
"H"レベルトリガ電圧	VT+(USB)	HVDD2 = 3.6V	1.1	-	1.8	V
"L"レベルトリガ電圧	VT-(USB)	HVDD2 = 3.0V	1.0	-	1.5	V
ヒステリシス電圧	$\Delta V(USB)$	HVDD2 = 3.0V	0.1	-	-	V
入力特性 (USB:FS 差動入力)	端子名 :	DP, DM のペア				
差動入力の感度		HVDD2 = 3.0V				
	VDS(USB)	差動入力電圧 0.8V~2.5V	-	-	0.2	V
入力プルアップ特性	端子名 :	xRESET				
プルアップ抵抗値	RPU2	HVDD = 3.3V	60	120	288	k Ω
		VIH = VSS				
入力プルアップ特性	端子名 :	ID				
プルアップ抵抗値	RPU2	HVDD2 = 3.3V VIH = VSS	60	120	288	k Ω
入力プルダウン特性	端子名 :	SCANEN, ATPGEN, TIN2, TIN1, TIN0, COMPIN10, COMPIN22				
プルダウン抵抗値	RPD2	HVDD = 3.3V VIH = VSS	60	120	288	k Ω

7. 電気的特性

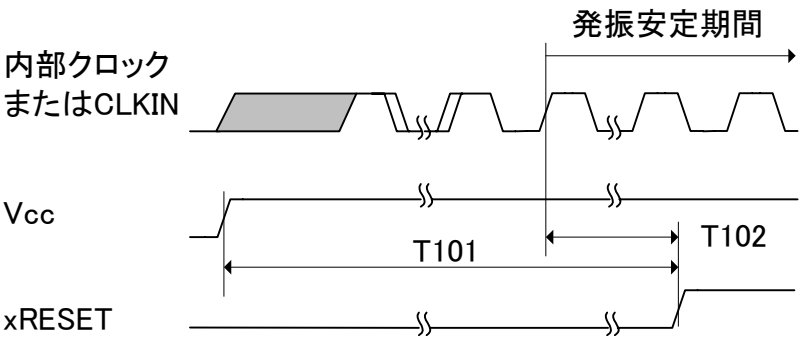
DC 特性(推奨動作条件による) (3)

項 目	記 号	条 件	MIN	TYP	MAX	単位
出力特性	端子名 : CD15..CD0, xINT, xWAIT, xDREQ					
"H"レベル出力電圧	VOH1H	HVDD = 2.7V IOH = -3mA	VDD-0.4	-	-	V
"L"レベル出力電圧	VOL1H	HVDD = 2.7V IOL = 3mA	-	-	0.4	V
出力特性	端子名 : xRPUEN, RPDEN, VBUSDRV3, VBUSDRV5, BUSPWRSEL					
"H"レベル出力電圧	VOH1H	HVDD = 3.0V IOH = -3mA	VDD-0.4	-	-	V
"L"レベル出力電圧	VOL1H	HVDD = 3.0V IOL = 3mA	-	-	0.4	V
出力特性 (USB:FS)	端子名 : DP, DM					
"H"レベル出力電圧	VOH(USB)	HVDD = 3.0V	2.8	-	-	V
"L"レベル出力電圧	VOL(USB)	HVDD = 3.6V	-	-	0.3	V
出力特性	端子名 : xRPUEN, RPDEN, VBUSDRV3, VBUSDRV5, BUSPWRSEL, CD15..CD0, xINT, xWAIT, xDREQ					
OFF-STATE リーク電流	IOZ1H	HVDD = 3.6V VOH = VDD VOL = VSS	-5	-	5	μA
端子容量	端子名 : 全入力端子					
入力端子容量	CI	f = 1MHz VDD = VSS	-	-	8	pF
端子容量	端子名 : 全出力端子					
出力端子容量	CO	f = 1MHz VDD = VSS	-	-	8	pF
端子容量	端子名 : 全入出力端子					
入出力端子容量	CIO	f = 1MHz VDD = VSS	-	-	8	pF

7.4 AC 特性

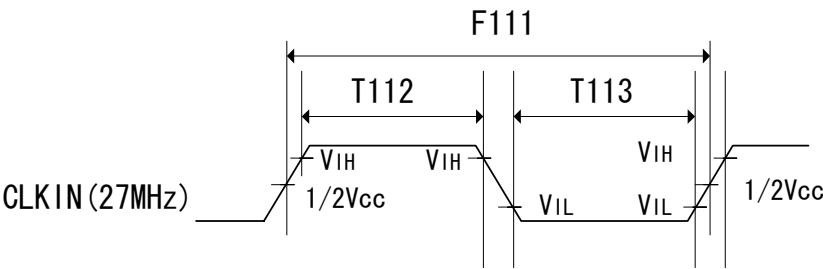
7.4.1 クロックタイミング

7.4.1.1 パワーオン発振安定時間



記号	説明	min	typ	max	単位
T101	パワーオン発振安定時間	10	-	-	ms
T102	XRESET セットアップ時間	200	-	-	us

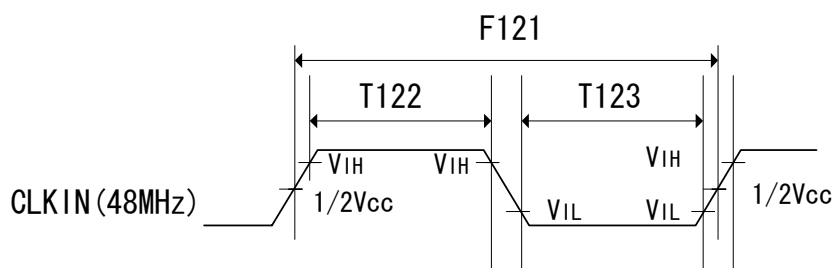
7.4.1.2 CLKIN(27MHz)クロック入力タイミング



記号	説明	min	typ	max	単位
F111	クロック入力周波数	26.933	27.000	27.068	MHz
T112	クロック入力 High レベルパルス幅	12	-	23	ns
T113	クロック入力 Low レベルパルス幅	12	-	23	ns

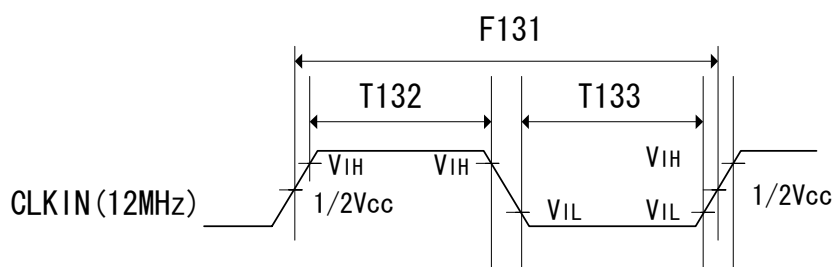
7. 電気的特性

7.4.1.3 CLKIN(48MHz) クロック入力タイミング



記号	説明	min	typ	max	単位
F121	クロック入力周波数(中心周波数)	47.880	48	48.120	MHz
T122	クロック入力 High レベルパルス幅	7	-	13	ns
T123	クロック入力 Low レベルパルス幅	7	-	13	ns

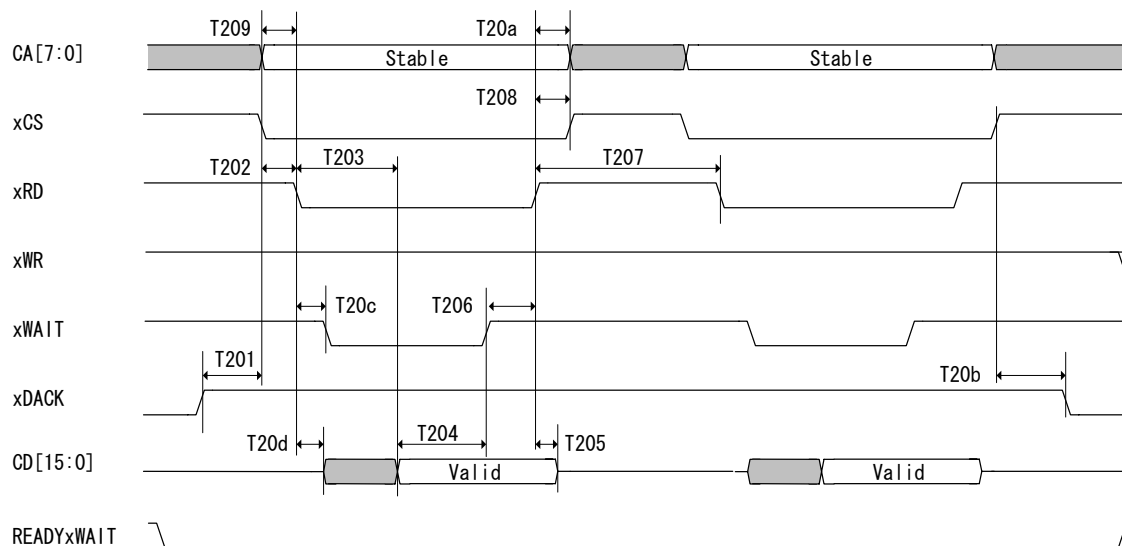
7.4.1.4 CLKIN(12MHz) クロック入力タイミング



記号	説明	min	typ	max	単位
F131	クロック入力周波数 (中心周波数)	11.970	12.000	12.030	MHz
T132	クロック入力 High レベルパルス幅	28	-	52	ns
T133	クロック入力 Low レベルパルス幅	28	-	52	ns

7.4.2 CPU I/F アクセス タイミング

7.4.2.1 リード タイミング (外部 xWAIT モード)



記号	説明	min	typ	max	単位
T201	xDACK 起点对する xCS 上昇時間	10	-	-	ns
T202	xCS 上昇点对する xRD 上昇時間	0	-	-	ns
T203	xRD 上昇点对する CD 有効データ遅延時間(注 1)	-	-	62.5	ns
T204	CD 出力に対する xWAIT 起点对時間	20	-	-	ns
T205	xRD 起点对する CD 出力ホールド時間	2.5	-	-	ns
T206	xWAIT 起点对する xRD 起点对時間	0	-	-	ns
T207	xRD 起点对期間	25	-	-	ns
T208	xRD 起点对する xCS 起点对時間	0	-	-	ns
T209	xRD 上昇点对する CA セットアップ時間	0	-	-	ns
T20a	xRD 起点对する CA ホールド時間	0	-	-	ns
T20b	xCS 起点对する xDACK 上昇時間	10	-	-	ns
T20c	xRD 上昇点对する xWAIT 上昇時間	-	-	8	ns
T20d	xRD 上昇点对する CD 出力遅延時間	-	-	8	ns

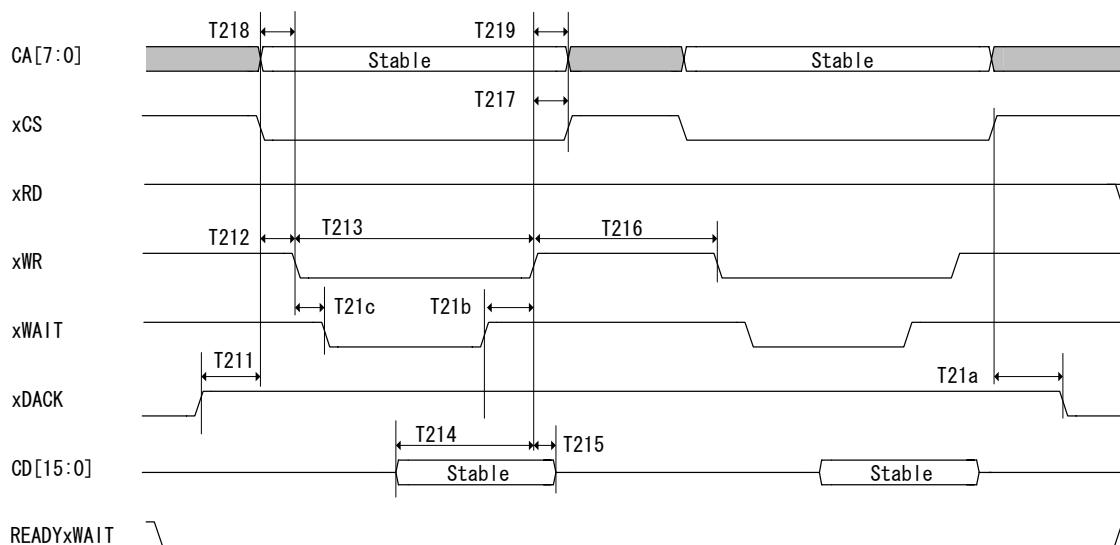
(注 1)

通常レジスタアクセス時の規定 (FIFO forCPU レジスタへのアクセス時を除く) です。

FIFO forCPU レジスタへのアクセス時は、内蔵 FIFO メモリへのアクセス競合の状況より、データ出力までの時間が延びます。

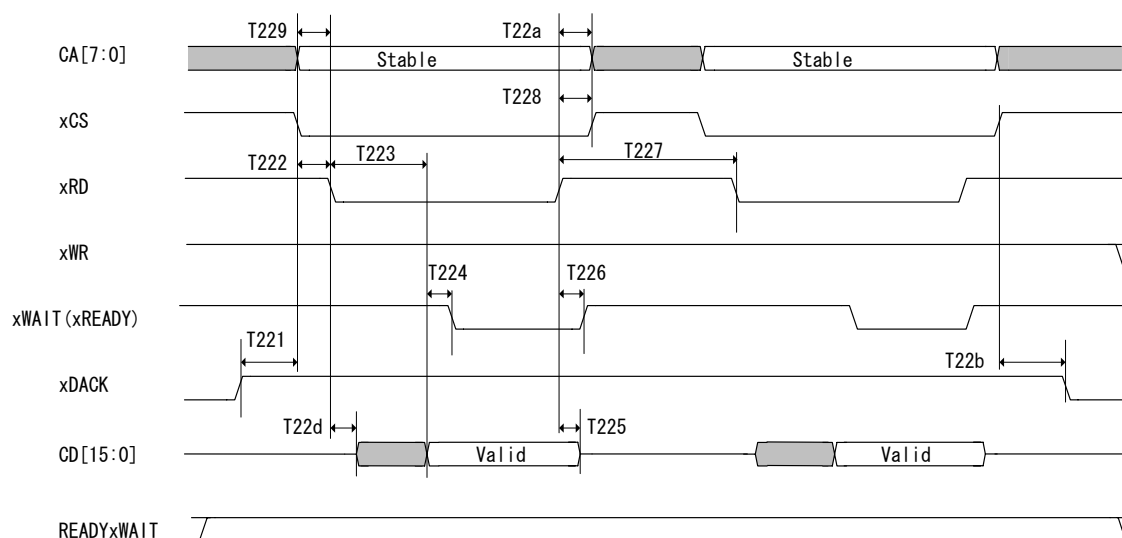
7. 電気的特性

7.4.2.2 ライト タイミング（外部 xWAIT モード）



記号	説明	min	typ	max	単位
T211	xDACK 断対する xCS 断時間	10	-	-	ns
T212	xCS 断対する xWR 断時間	0	-	-	ns
T213	xWR 断パルス幅	32	-	-	ns
T214	xWR 断対する CD セットアップ 時間	10	-	-	ns
T215	xWR 断対する CD ホールド 時間	0	-	-	ns
T216	xWR 断期間	25	-	-	ns
T217	xWR 断対する xCS 断時間	0	-	-	ns
T218	xWR 断対する CA セットアップ 時間	0	-	-	ns
T219	xWR 断対する CA ホールド 時間	0	-	-	ns
T21a	xCS 断対する xDACK 断時間	10	-	-	ns
T21b	xWAIT 断対する xWR 断時間	0	-	-	ns
T21c	xWR 断対する xWAIT 断時間(注 2)	-	-	8	ns

7.4.2.3 リード タイミング (外部 xREADY モード)



記号	説明	min	typ	max	単位
T221	xDACK へに対する xCS アサート時間	10	-	-	ns
T222	xCS アサートに対する xRD アサート時間	0	-	-	ns
T223	xRD アサートに対する CD 有効データ遅延時間(注 1)	-	-	62.5	ns
T224	CD 出力に対する xREADY アサート時間	15	-	-	ns
T225	xRD へに対する CD 出力ホールド時間	2.5	-	-	ns
T226	xRD へに対する xREADY へに対する時間		-	8	ns
T227	xRD へに対する期間	25	-	-	ns
T228	xRD へに対する xCS へに対する時間	0	-	-	ns
T229	xRD アサートに対する CA セットアップ時間	0	-	-	ns
T22a	xRD へに対する CA ホールド時間	0	-	-	ns
T22b	xCS へに対する xDACK アサート時間	10	-	-	ns
T22c	-	-	-	-	ns
T22d	xRD アサートに対する CD 出力遅延時間	-	-	8	ns

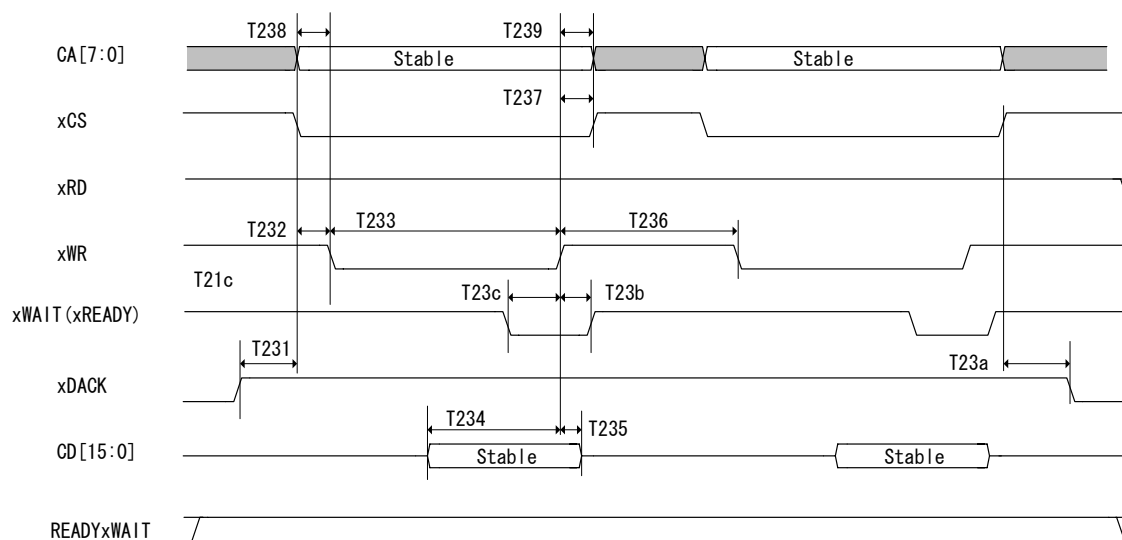
(注 1)

通常レジスタアクセス時の規定 (FIFO forCPU レジスタへのアクセス時を除く) です。

FIFO forCPU レジスタへのアクセス時は、内蔵 FIFO メモリへのアクセス競合の状況より、データ出力までの時間が延びます。

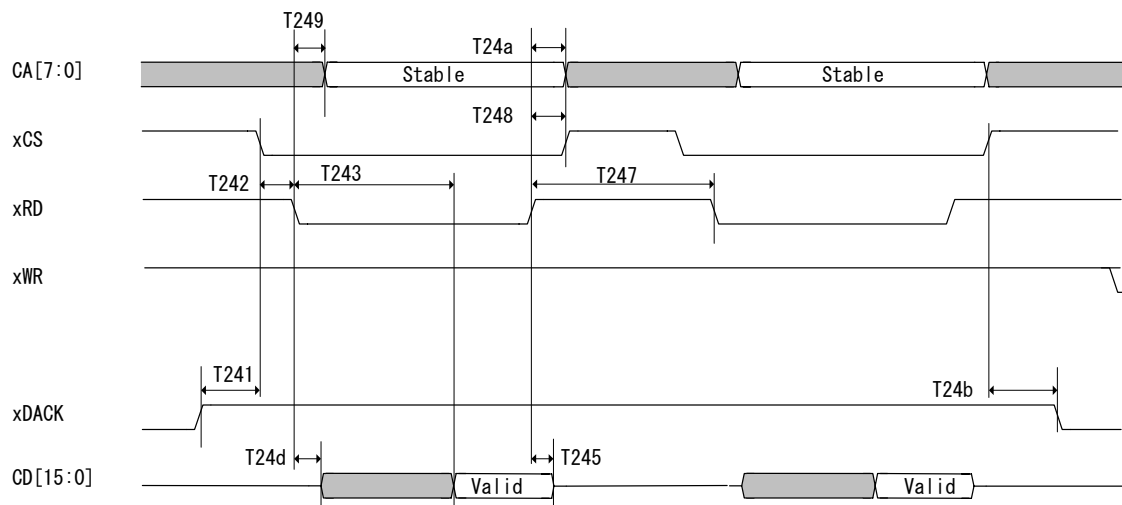
7. 電気的特性

7.4.2.4 ライト タイミング (外部 xREADY モード)



記号	説明	min	typ	max	単位
T231	xDACK ねーとに対する xCS アサート時間	10	-	-	ns
T232	xCS アサートに対する xWR アサート時間	0	-	-	ns
T233	xWR アサートパルス幅	32	-	-	ns
T234	xWR ねーとに対する CD セットアップ 時間	10	-	-	ns
T235	xWR ねーとに対する CD ホールド 時間	0	-	-	ns
T236	xWR ねーと期間	25	-	-	ns
T237	xWR ねーとに対する xCS ねーと時間	0	-	-	ns
T238	xWR アサートに対する CA セットアップ 時間	0	-	-	ns
T239	xWR ねーとに対する CA ホールド 時間	0	-	-	ns
T23a	xCS ねーとに対する xDACK アサート時間	10	-	-	ns
T23b	xWR ねーとに対する xREADY ねーと時間	-	-	8	ns
T23c	xREADY アサートに対する xWR ねーと時間	0	-	-	ns

7.4.2.5 リード タイミング (固定 WAIT モード)

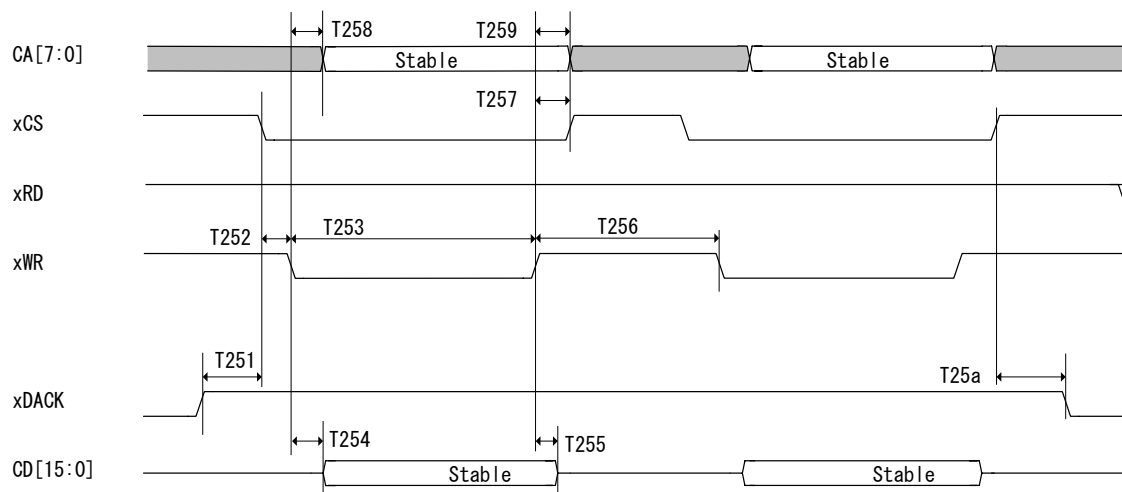


記号	説明	min	typ	max	単位
T241	xDACK ねーとに対する xCS ねーと時間	10	-	-	ns
T242	xCS ねーとに対する xRD ねーと時間	0	-	-	ns
T243	xRD ねーとに対する CD 有効データ出力遅延時間	-	-	110	ns
T244	-	-	-	-	ns
T245	xRD ねーとに対する CD 出力ホールド 時間	2.5	-	-	ns
T246	-	-	-	-	ns
T247	xRD ねーと期間	25	-	-	ns
T248	xRD ねーとに対する xCS ねーと時間	0	-	-	ns
T249	xRD ねーとに対する CA 有効遅延時間	-	-	10	ns
T24a	xRD ねーとに対する CA ホールド 時間	0	-	-	ns
T24b	xCS ねーとに対する xDACK ねーと時間	10	-	-	ns
T24c	-	-	-	-	ns
T24d	xRD ねーとに対する CD 出力遅延時間	-	-	8	ns

- ・ 固定 WAIT モードの選択は、S1R72005 の CPUConfig レジスタにて行います。
- ・ 本 LSI はパワーオンリセット後 外部 xWAIT を使用するモードで動作します。
- ・ CPUConfig レジスタへアクセス時は xWAIT が出力されませんので xWAIT を持たない CPU から書きこみできます。
- ・ 外部 WAIT 端子を使用しない場合、CPU は上記のタイミングでアクセス可能なように本デバイスにアクセス時にソフトウェイトを割り当ててください。

7. 電気的特性

7.4.2.6 ライト タイミング（固定 WAIT モード）

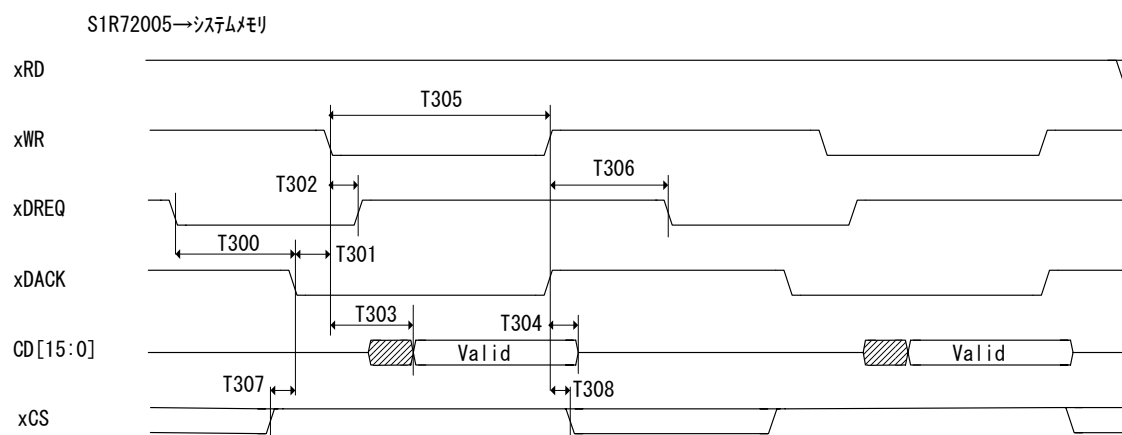


記号	説明	min	typ	max	単位
T251	xDACK に対する xCS アセット時間	10	-	-	ns
T252	xCS アセットに対する xWR アセット時間	0	-	-	ns
T253	xWR アセットパルス幅	110	-	-	ns
T254	xWR アセットに対する CD 有効遅延時間	-	-	20	ns
T255	xWR に対する CD ホールド時間	0	-	-	ns
T256	xWR に対する期間	25	-	-	ns
T257	xWR に対する xCS に対する時間	0	-	-	ns
T258	xWR アセットに対する CA 有効遅延時間	0	-	-	ns
T259	xWR に対する CA ホールド時間	0	-	-	ns
T25a	xCS に対する xDACK アセット時間	10	-	-	ns

- ・固定 WAIT モードの選択は、S1R72005 の CPUConfig レジスタにて行います。
- ・本 LSI はパワーオンリセット後 外部 xWAIT を使用するモードで動作します。
- ・CPUConfig レジスタへアクセス時は xWAIT が出力されませんので xWAIT を持たない CPU から書きこみできます。
- ・外部 WAIT 端子を使用しない場合、CPU は上記のタイミングでアクセス可能なように本デバイスにアクセス時にソフトウェアウェイトを割り当ててください。

7.4.3 DMA タイミング

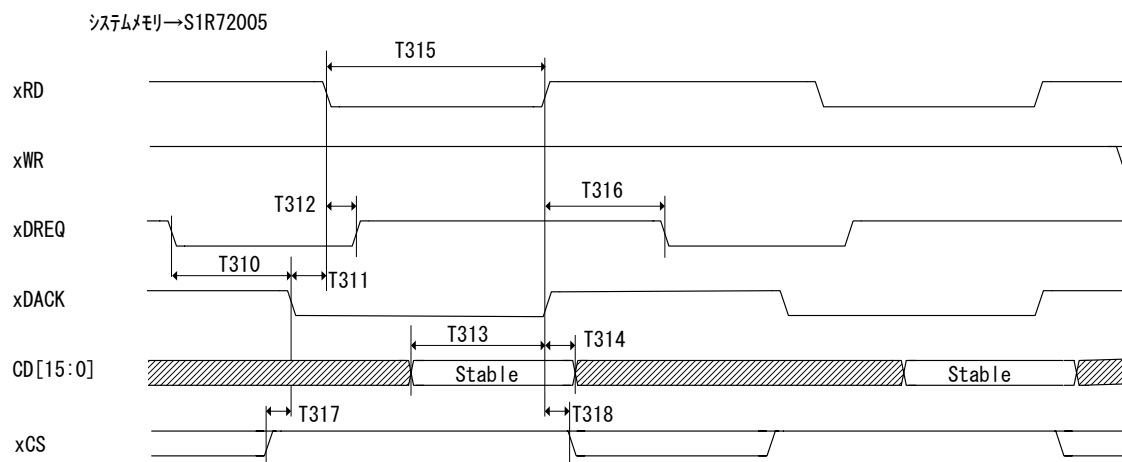
7.4.3.1 xRD・xWR ストローブモード(DMAOUT)



記号	説明	min	typ	max	単位
T300	xDREQ アサートに対する xDACK アサート時間	0	-	-	ns
T301	xDACK アサートに対する xWR アサート時間	0	-	-	ns
T302	xWR アサートに対する xDREQ 遅延時間	-	-	10	ns
T303	xWR アサートに対するデータ出力遅延時間	-	-	8	ns
T304	xWR 遅延に対するデータ出力遅延時間	2	-	-	ns
T305	xWR アサートパルス幅	42	-	-	ns
T306	xWR 遅延に対する xDREQ アサート時間	160	-	-	ns
T307	xCS 遅延に対する xDACK アサート時間	0	-	-	ns
T308	xDACK 遅延に対する xCS アサート時間	0	-	-	ns

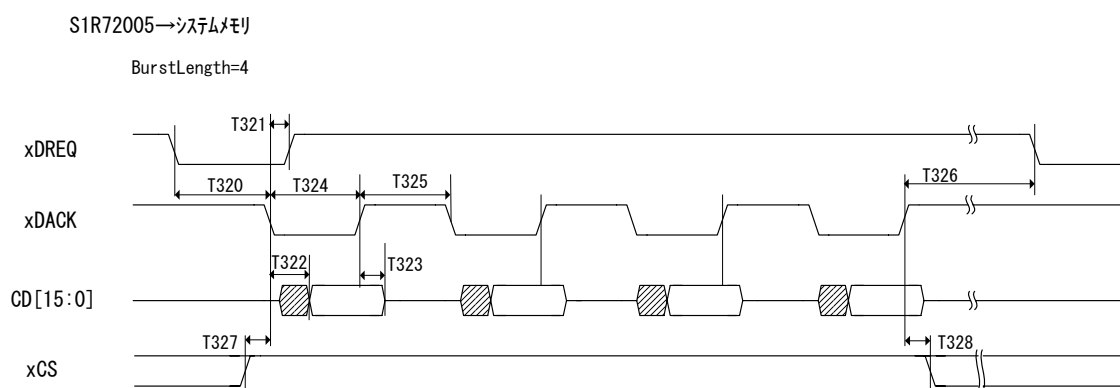
7. 電気的特性

7.4.3.2 xRD・xWR ストローブモード(DMAIN)



記号	説明	min	typ	max	単位
T310	xDREQ アサートに対する xDACK アサート時間	0	-	-	ns
T311	xDACK アサートに対する xRD アサート時間	0	-	-	ns
T312	xRD アサートに対する xDREQ 撤去時間	-	-	10	ns
T313	xRD 撤去に対するデータセットアップ時間	10	-	-	ns
T314	xRD 撤去に対するデータホールド時間	0	-	-	ns
T315	xRD アサートパルス幅	42	-	-	ns
T316	xRD 撤去に対する xDREQ アサート時間	160	-	-	ns
T317	xCS 撤去に対する xDACK アサート時間	0	-	-	ns
T318	xDACK 撤去に対する xCS アサート時間	0	-	-	ns

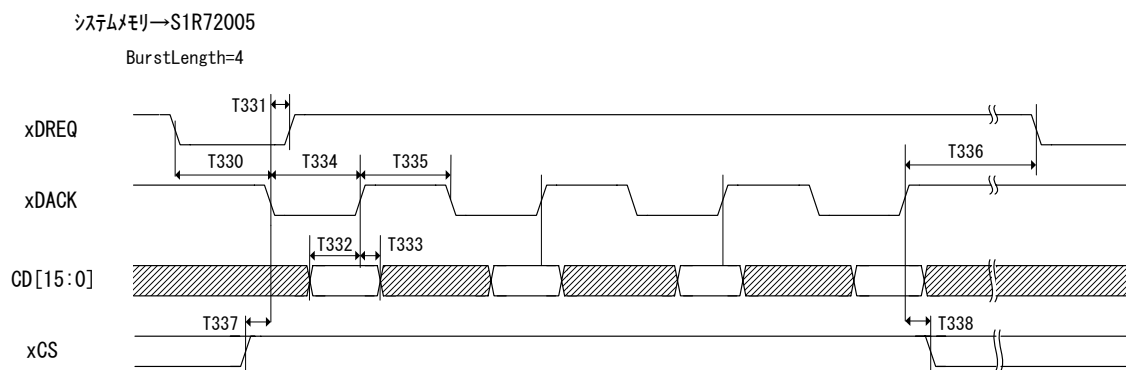
7.4.3.3 DACK ストローブモード(DMAOUT)



記号	説明	min	typ	max	単位
T320	xDREQ アサートに対する xDACK アサート時間	0	-	-	ns
T321	xDACK アサートに対する xDREQ リセット時間	-	-	10	ns
T322	xDACK アサートに対するデータ出力遅延時間	-	-	7	ns
T323	xDACK リセットに対するデータ入力遅延時間	2	-	-	ns
T324	xDACK アサートパルス幅	42	-	-	ns
T325	xDACK リセットパルス幅	42	-	-	ns
T326	xDACK リセットに対する xDREQ アサート時間	160	-	-	ns
T327	xCS リセットに対する xDACK アサート時間	0	-	-	ns
T328	xDACK リセットに対する xCS アサート時間	0	-	-	ns

7. 電気的特性

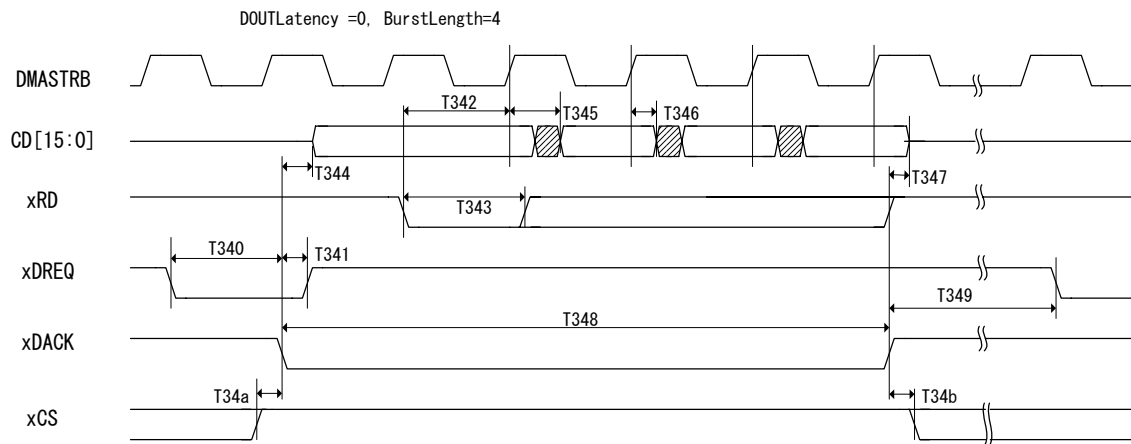
7.4.3.4 DACK ストローブモード(DMAIN)



記号	説明	min	typ	max	単位
T330	xDREQ アサートに対する xDACK アサート時間	0	-	-	ns
T331	xDACK アサートに対する xDREQ 撤アート時間	-	-	10	ns
T332	xDACK 撤アートに対するデータセットアップ時間	10	-	-	ns
T333	xDACK 撤アートに対するデータホルト時間	0	-	-	ns
T334	xDACK アサートパルス幅	42	-	-	ns
T335	xDACK 撤アートパルス幅	42	-	-	ns
T336	xDACK 撤アートに対する xDREQ アサート時間	160	-	-	ns
T337	xCS 撤アートに対する xDACK アサート時間	0	-	-	ns
T338	xDACK 撤アートに対する xCS アサート時間	0	-	-	ns

7.4.3.5 DMASTRB SDRAM モード(DMAOUT)

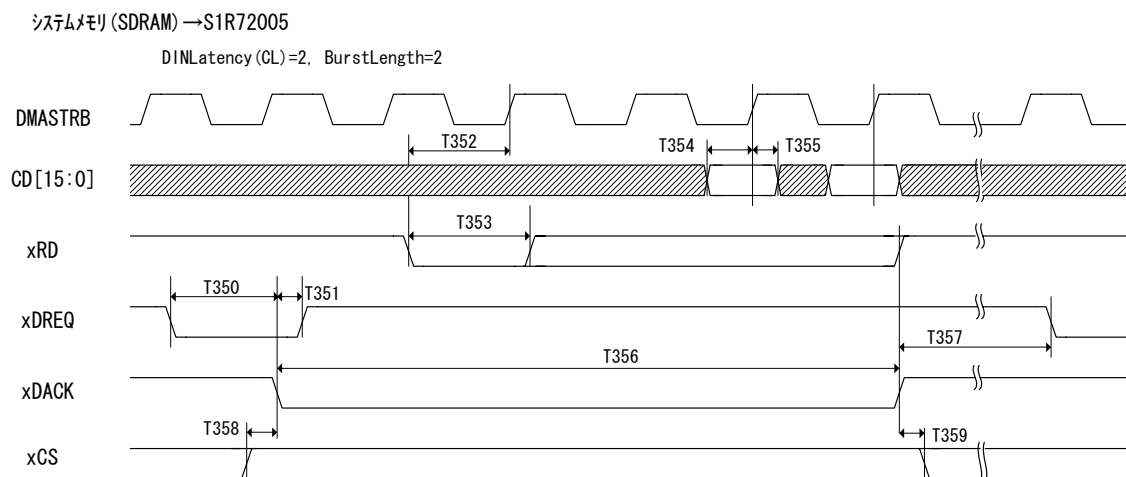
S1R72005→システムメモリ (SDRAM)



記号	説明	min	typ	max	単位
T340	xDREQ アサートに対する xDACK アサート時間	0	-	-	ns
T341	xDACK アサートに対する xDREQ レポート時間	-	-	10	ns
T342	xRD(～CAS)アサートに対する DMASTRB 有効エッジ 時間	3	-	-	ns
T343	xRD(～CAS)アサートパルス幅	1T (DMASTRB)	-	-	ns
T344	xDACK アサートに対するデータ出力遅延時間	-	-	7	ns
T345	DMASTRB 有効エッジに対するデータ出力遅延時間	-	-	9	ns
T346	DMASTRB 有効エッジに対するデータホールド 時間	4	-	-	ns
T347	xDACK レポートに対するデータホールド 時間	2	-	-	ns
T348	xDACK アサートパルス幅	42	-	-	ns
T349	xDACK レポートに対する xDREQ アサート時間	160	-	-	ns
T34a	xCS レポートに対する xDACK アサート時間	0	-	-	ns
T34b	xDACK レポートに対する xCS アサート時間	0	-	-	ns

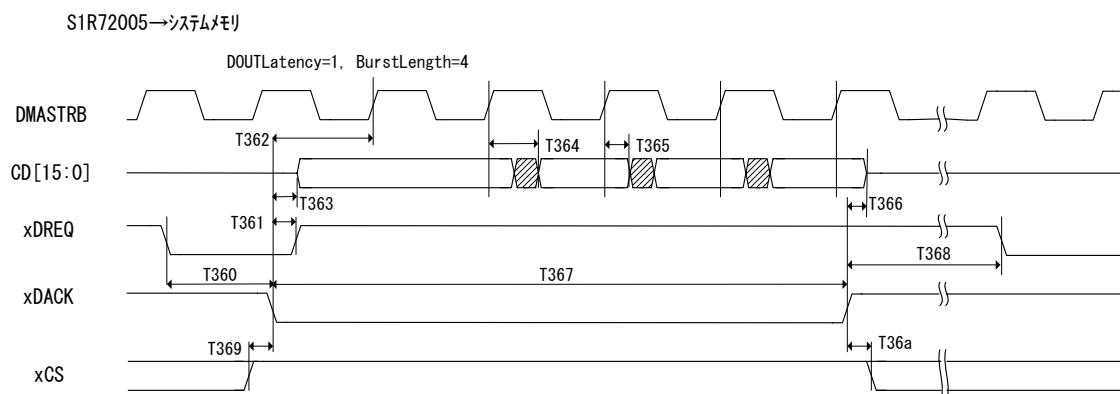
7. 電気的特性

7.4.3.6 DMASTRB SDRAM モード(DMAIN)



記号	説明	min	typ	max	単位
T350	xDREQ アサートに対する xDACK アサート時間	0	-	-	ns
T351	xDACK アサートに対する xDREQ 撤アサート時間	-	-	10	ns
T352	xRD(〜CAS)アサートに対する DMASTRB 有効エッジ 時間	3	-	-	ns
T353	xRD(〜CAS)アサートパルス幅	1T (DMASTRB)	-	-	ns
T354	DMASTRB 有効エッジ に対する データセットアップ 時間	10	-	-	ns
T355	DMASTRB 有効エッジ に対する データホルト 時間	0	-	-	ns
T356	xDACK アサートパルス幅	42	-	-	ns
T357	xDACK 撤アサートに対する xDREQ アサート時間	160	-	-	ns
T358	xCS 撤アサートに対する xDACK アサート時間	0	-	-	ns
T359	xDACK 撤アサートに対する xCS アサート時間	0	-	-	ns

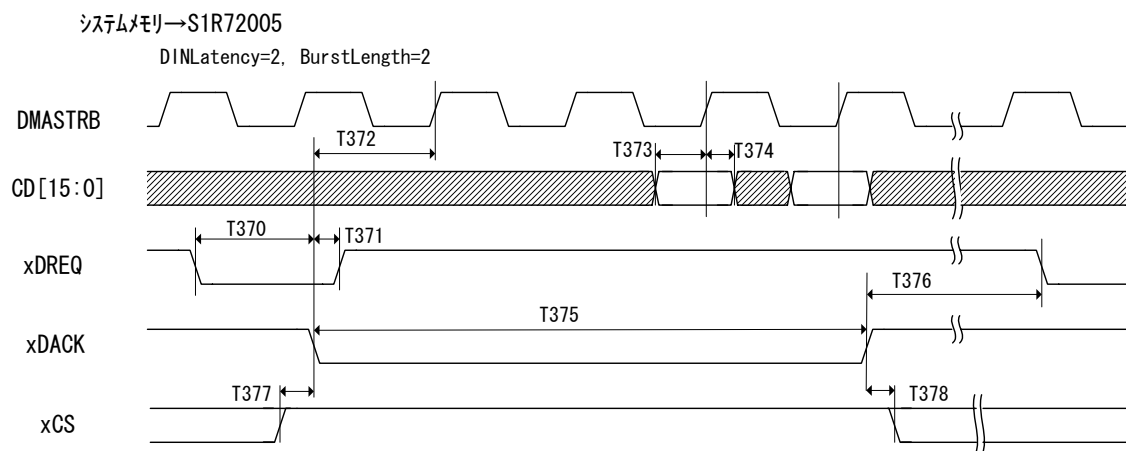
7.4.3.7 DMASTRB 汎用モード (DMAOUT)



記号	説明	min	typ	max	単位
T360	xDREQ アサートに対する xDACK アサート時間	0	-	-	ns
T361	xDACK アサートに対する xDREQ 撤アート時間	-	-	10	ns
T362	xDACK アサートに対する DMASTRB 有効エッジ 時間	3	-	-	ns
T363	xDACK アサートに対する出力データ遅延時間	-	-	7	ns
T364	DMASTRB 有効エッジ に対する 出力データ遅延時間	-	-	9	ns
T365	DMASTRB 有効エッジ に対する 出力データホールド 時間	4	-	-	ns
T366	xDACK 撤アート に対する データホールド 時間	2	-	-	ns
T367	xDACK アサートパルス幅	42	-	-	ns
T368	xDACK 撤アート に対する xDREQ アサート時間	160	-	-	ns
T369	xCS 撤アート に対する xDACK アサート時間	0	-	-	ns
T36a	xDACK 撤アート に対する xCS アサート時間	0	-	-	ns

7. 電気的特性

7.4.3.8 DMASTRB 汎用モード (DMAIN)



記号	説明	min	typ	max	単位
T370	xDREQ アサートに対する xDACK アサート時間	0	-	-	ns
T371	xDACK アサートに対する xDREQ 撤去時間	-	-	10	ns
T372	xDACK アサートに対する DMASTRB 有効エッジ時間	3	-	-	ns
T373	DMASTRB 有効エッジに対する データセットアップ時間	10	-	-	ns
T374	DMASTRB 有効エッジに対する データホールド時間	0	-	-	ns
T375	xDACK アサートパルス幅	42	-	-	ns
T376	xDACK 撤去に対する xDREQ アサート時間	160	-	-	ns
T377	xCS 撤去に対する xDACK アサート時間	0	-	-	ns
T378	xDACK 撤去に対する xCS アサート時間	0	-	-	ns

7.4.4 USB I/F タイミング

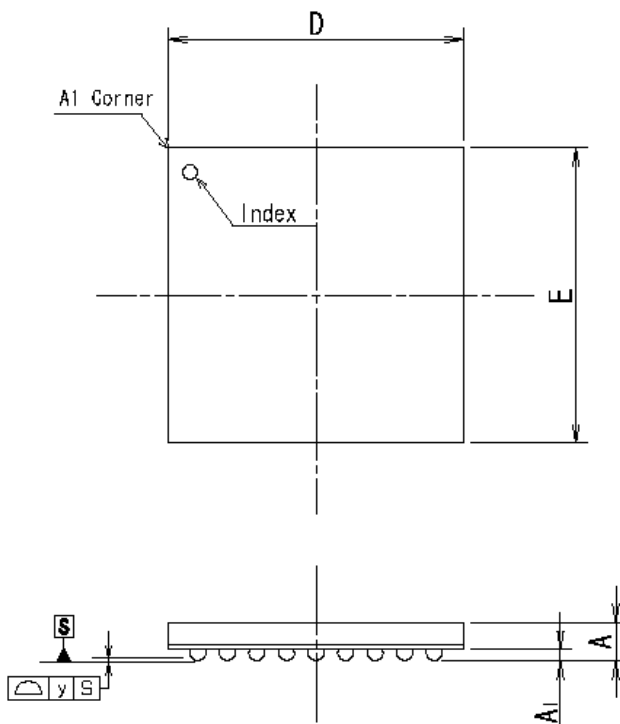
USB2.0 規格に準拠しています。

8. 外形寸法図

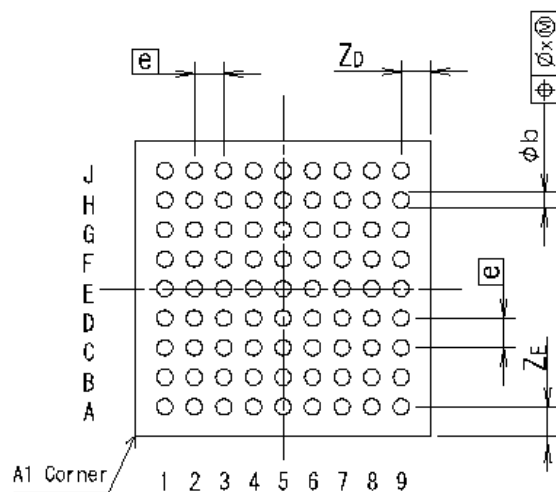
8. 外形寸法図

8.1 CSP パッケージ

Top View



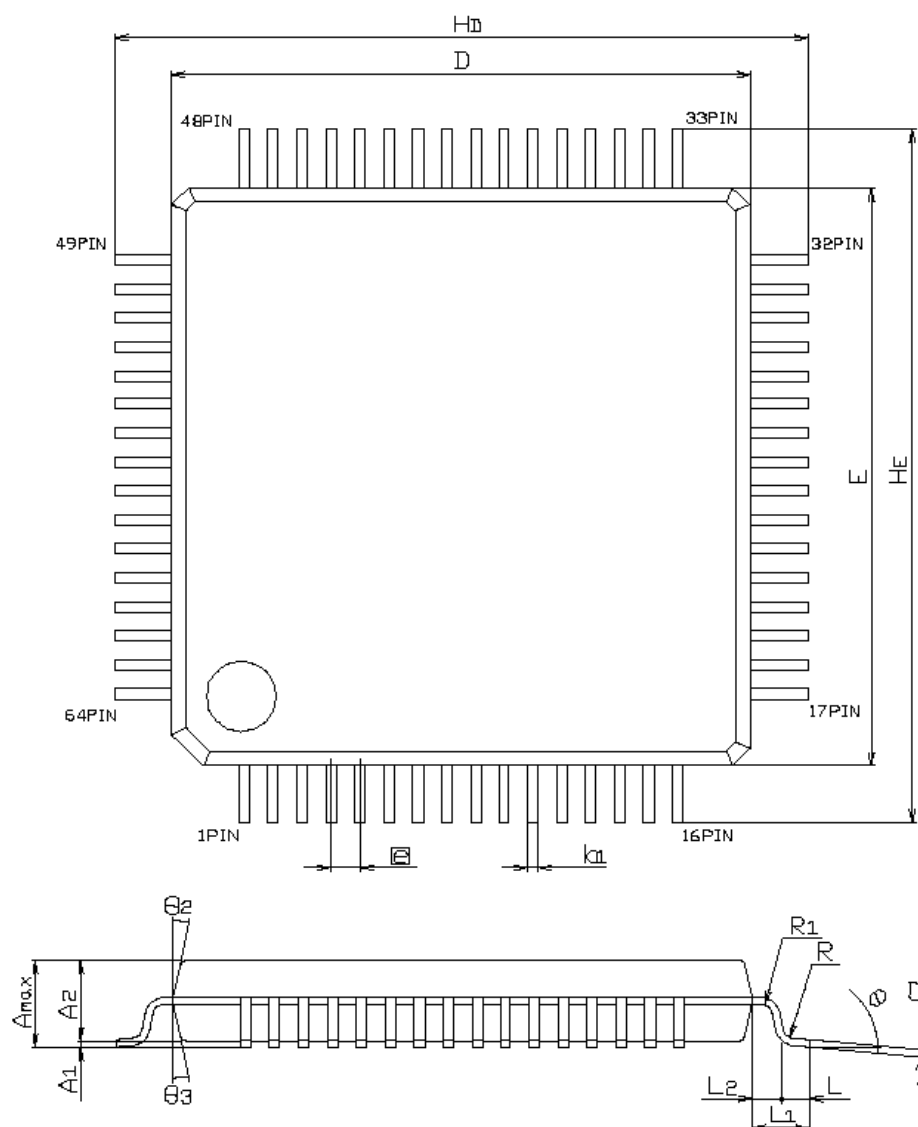
Bottom View



Symbol	Dimension in Millimeters		
	Min	Nom	Max
D	7.80	8.0	8.2
E	7.80	8.0	8.2
A			1.20
A ₁	0.25	0.30	0.35
e		0.80	
b	0.38	0.43	0.48
X			0.08
Y			0.10
Z _b		0.80	
Z _E		0.80	

1 = 1mm

8.2 QFP パッケージ



Symbol	Dimension in Millimeters		
	Min	Nom	Max
E	9.9	10	10.1
D	9.9	10	10.1
A_{max}			1.7
A_1		0.1	
A_2	1.3	1.4	1.5
θ_1		0.5	
θ_2	0.13	0.18	0.28
θ_3	0.1	0.125	0.175
θ	0°		10°
L	0.3	0.5	0.7
L_1		1	
L_2		0.5	
H_E	11.6	12	12.4
H_D	11.6	12	12.4
R_1		12°	
R		12°	
L		0.2	
L_1		0.2	

9. 接続例

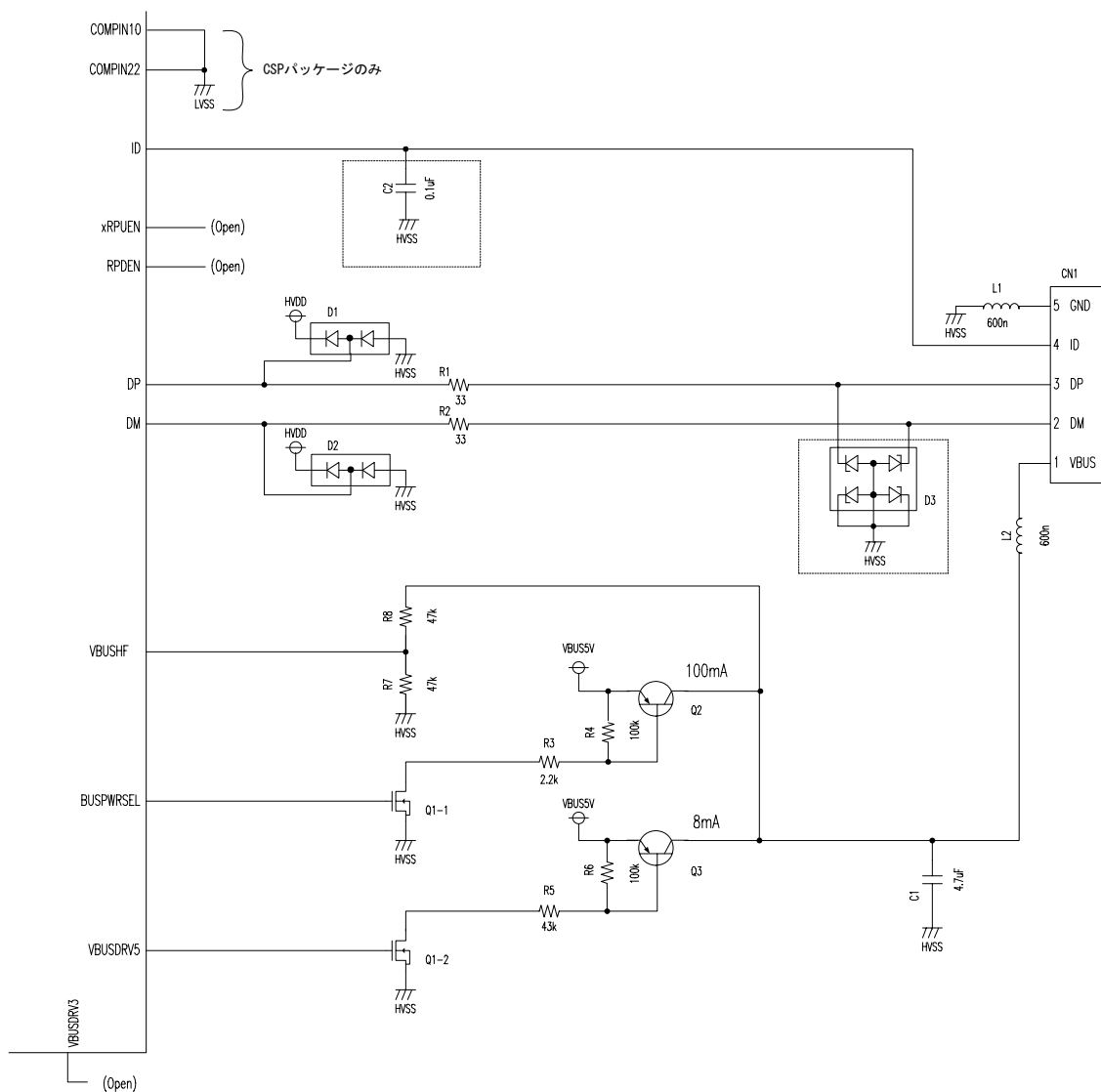
9. 接続例

外部周辺回路の接続例（参考例）を示します。

(注) 当接続例はあくまで参考例であり、お客様の製品での動作を保証するものではありません。

回路構成の詳細および部品の選定につきましては、お客様にてあらためて御検討ください。

9.1 OTG I/F 端子接続例



(接続上の注意)

- ・ 静電気保護のため、必ずD1およびD2のダイオードによる保護回路を設けてください。その場合、ダイオードは特性および定格等を考慮のうえ選定してください。
- ・ さらなる静電気保護のためには、D3のダイオードを使用することも考えられます。
- ・ C1は1.0μF～6.5μFの範囲で選択可能です。
- ・ ID端子の静電気保護のためにC2を使用することも考えられます。
- ・ DPおよびDMラインは同長かつ短く配線してください。
- ・ OTG I/F部配線の直近直下に他の配線をしないでください。

接続部品例

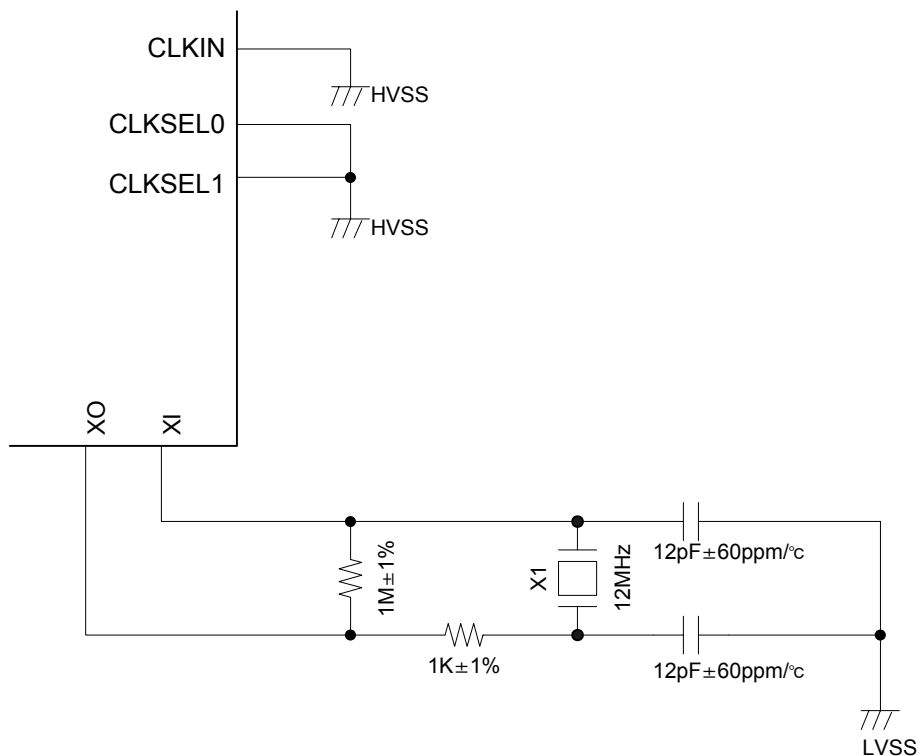
(注) 本部品表はあくまで参考例であり、お客様の製品での動作を保証するものではありません。部品の選定につきましては、お客様にてあらためて御検討ください。

項	記号	部品名	部品型番	仕様(定数)	動作温度(℃)	メーカー	部品数
1	C1	セラミックコンデンサ	GRM31MF11C475ZA12B	16V 4.7uF	-25～85	村田製作所	1
2	C2	セラミックコンデンサ	GRM40F104Z50PT	0.1uF	-25～85	村田製作所	1
3	L1, L2	EMI Filter	BLM21PG600SN1	600nH	-55～125	村田製作所	2
4	R1, R2	抵抗	RK73H1JTD33F	33 Ω	-55～125	KOA	2
5	R3	抵抗	RK73H1JTD2.2kD	2.2k Ω	-55～125	KOA	1
6	R4, R6	抵抗	RK73H1JTD100kD	100k Ω	-55～125	KOA	2
7	R5	抵抗	RK73H1JTD43kD	43k Ω	-55～125	KOA	1
8	R7, R8	抵抗	RK73H2BTD47kF	47k Ω	-55～125	KOA	2
9	Q1	FET	TPCS8205		-55～150	東芝	1
10	Q2, Q3	トランジスタ	2SA1121	PNP	-55～125	日立	2
11	D1, D2	ダイオード	1SS396		-40～100	東芝	2
12	D3	ダイオード	NNCD5.6LG		-40～100	NEC	1
13	CN1	USBReceptacle	MNE20	USB miniAB	-	ACON	1

9. 接続例

9.2 クロック端子接続例

<水晶振動子使用時>

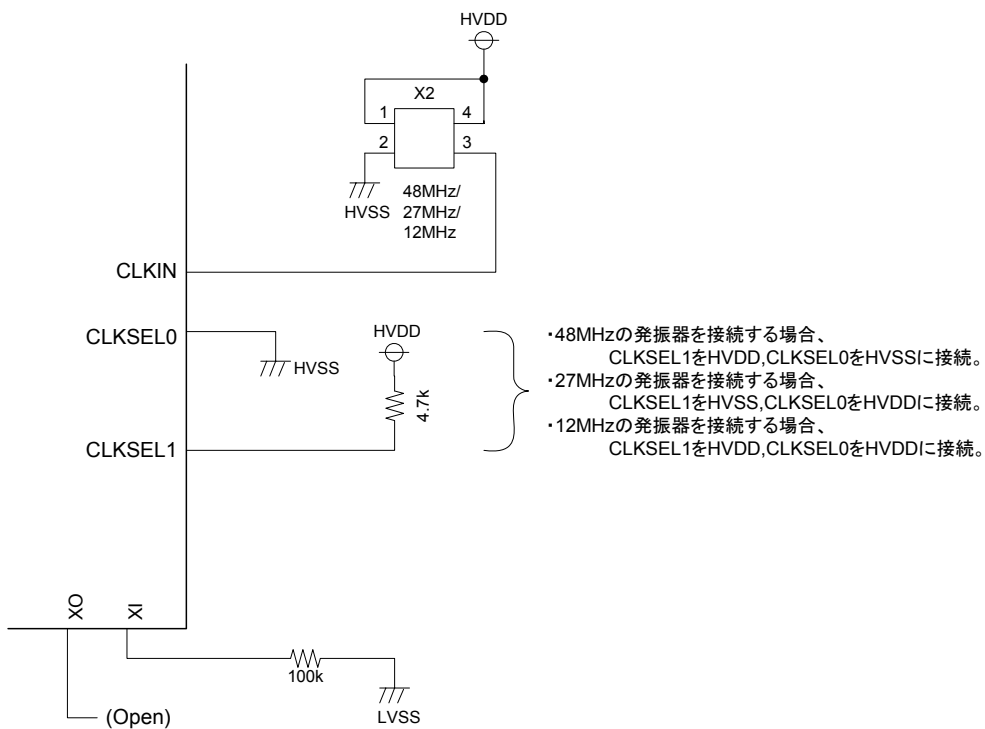


X1* : MA-406 12MHz 10pF 30ppm (EPSON)

(接続上の注意)

- クロック部配線の直近直下に他の配線をしないでください。
- XIおよびXOの回路および定数は、使用する水晶振動子X1の接続例を参考にしてください。
- XIおよびXOの回路は最短で配線してください。

＜水晶発振器（外部クロック入力）使用時＞



X2*： 例 SG-615PCW 48MHz±50ppm（EPSON）

中心周波数±50ppm 以下の水晶発振器を推奨いたします。

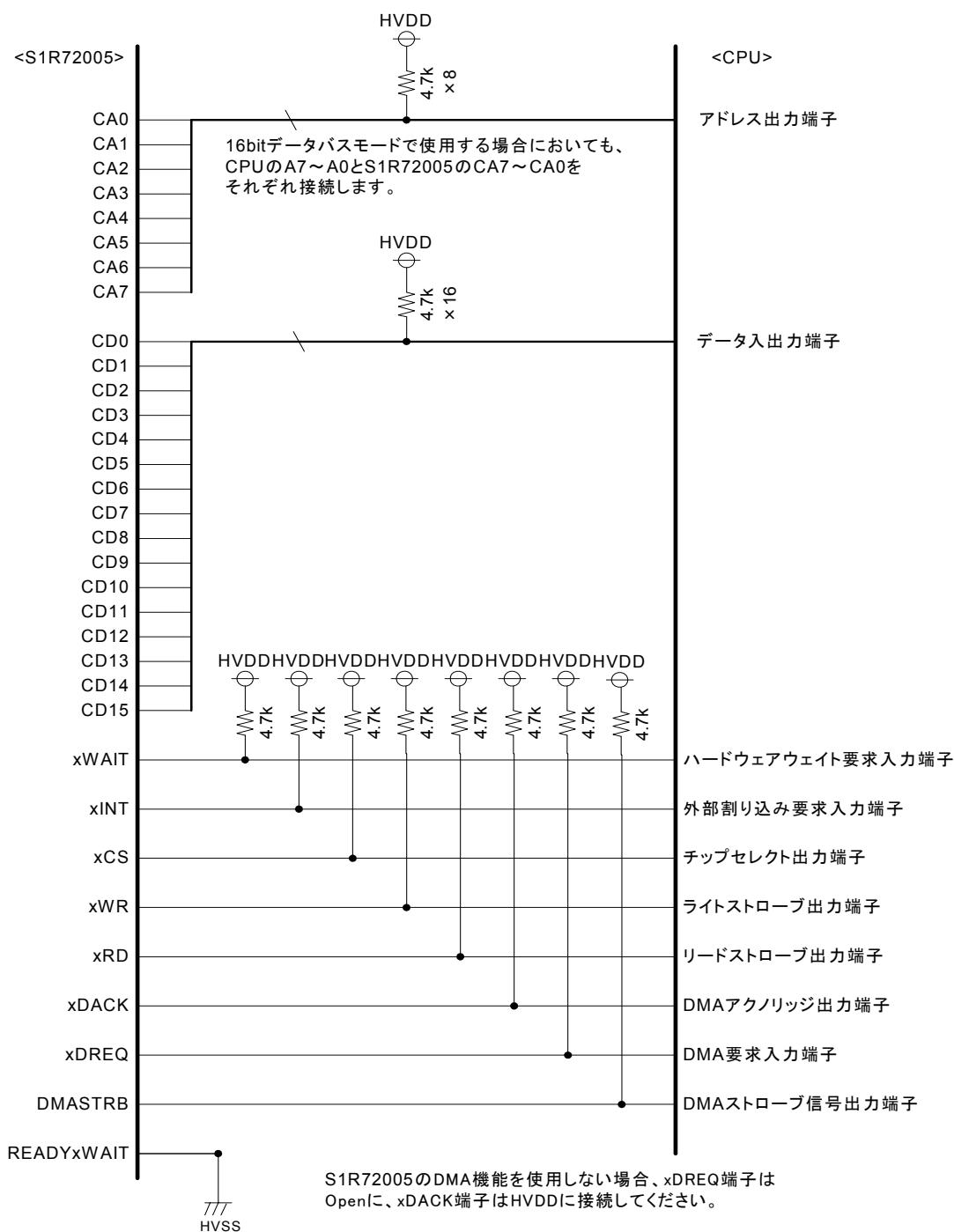
PLL デバイスはジッタが大きいため推奨できかねます。

（接続上の注意）

- クロック部配線の直近直下に他の配線をしないでください。
- CLKINの回路は、使用する水晶発振器X2の接続例を参考にしてください。
- CLKINの回路は最短で配線してください。
- CLKINの入力電圧は必要動作条件のHV_I入力電圧規定値を守ってください。
- XIの配線はできるだけ短くしてください。
- XOの配線はできるだけ短くしてオープンとしてください。

9. 接続例

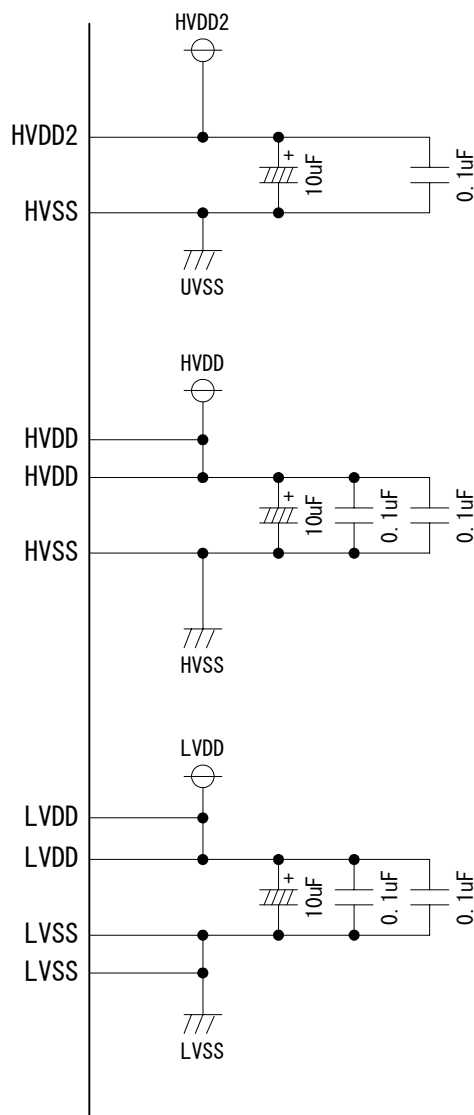
9.3 CPU I/F 端子接続例



(接続上の注意)

- READYxWAIT 端子は、お客様のシステムに合わせて必ず HVDD か HVSS に接続してください。
- PullUp 抵抗はお客様のシステムにおいて必要と判断された場合に、適切な値の抵抗をご使用ください。
- S1R72005 の DMASTRB 端子を未使用時は、本端子は HVSS に接続してください。
- データバスが 8bit の CPU と接続する場合、S1R72005 では下位 8bit を使用し、上位 8bit は HVSS に接続してください。

9.4 電源およびグランド端子接続例

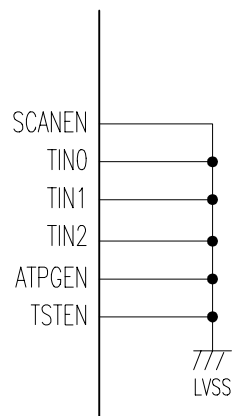


(接続上の注意)

- HVSS と CPU の I/O 用グランドとは共通のグランドとしてください。
- USB I/O 部に配置された HVDD 2 (CSP:G3、QFP:20 ピン) および HVSS (CSP:H5、QFP:23 ピン) は、端子専用に (上図最上部参照) コンデンサを接続してください。

9. 接続例

9.5 テスト端子接続例



(接続上の注意)

- すべてのテスト入力端子はかならず上図のように VSS へ接続してください。

本仕様書において掲載した応用回路例は、あくまで参考であって特許侵害を誘起させる目的ではありません。万一、これらの応用回路例を適用して特許侵害が生じたとしても、当社は何ら責任を負うものではありません。

セイコーエプソン株式会社
半導体事業部 IC 営業部

<IC 東日本営業グループ>

東京 〒191-8501 東京都日野市日野 421-8
TEL (042) 587-5313 (直通) FAX (042) 587-5116

<IC 西日本営業グループ>

大阪 〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-5-1 エプソン大阪ビル 15F
TEL (06) 6120-6000 (代表) FAX (06) 6120-6100
名古屋 〒460-0008 名古屋市中区栄 1-10-21 名古屋御園ビル 6F
TEL (052) 205-8421 (代表) FAX (052) 231-2538

ドキュメントコード : 410658400
2006 年 4 月 作成